

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零一八年第二季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2018年8月7日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一八年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一八年第二季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入再創新高，達 2.3 億美元，同比增長 16.1%，環比增長 9.4%。
- 毛利率 33.6%，同比上升 0.4 個百分點，環比上升 1.5 個百分點。
- 期內溢利 4,590 萬美元，同比上升 33.6%，環比上升 14.1%。
- 每股盈利 0.04 美元，同比上升 0.01 美元，環比持平。
- 淨資產收益率（年化）10.4%，同比上升 1.6 個百分點。

二零一八年第三季度指引

- 我們預計銷售收入環比增長 3% ~ 4%，同比增長 13% ~ 14%。
- 我們預計毛利率約為 32% ~ 33%。

總裁致辭

本公司總裁兼執行董事王煜先生，對第二季度的業績評論道：

“感谢客戶對我們技術的強勁需求和我們團隊的無縫協作，本季度業績表現超群！我很高興的宣佈，銷售收入再次創歷史新高，毛利率超越我們的預期。本季度銷售收入達 2.3 億美元，同比增長 16.1%，環比增長 9.4%。毛利率上升至 33.6%，同比上升 0.4 個百分點，環比上升 1.5 個百分點，主要得益於極高的產能利用率和完美且精確的產品組合。淨利潤率上升至 20%。強勁的業績歸功於產品應用的多樣化，尤其是銀行卡、MCU 和電源分立器件產品。”

王煜先生繼續說道，“展望未來，我們對 2018 年下半年充滿信心。MCU、分立器件、模擬和電源管理及邏輯與射頻產品的強勁需求將推動業務持續增長。同時，我們無錫工廠的建造正按計劃順利進行。我們目前正在著手準備四萬片晶圓產能首階段的相關設備。”

電話會議公告

日期： 二零一八年八月八日

時間： 下午 04:00（上海 / 香港）
上午 04:00（紐約，2018 年 8 月 8 日）

發言人： 王煜，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php or
https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2018_q2_earnings_call

電話詳細： 國際 +65 6713 5521
 中國 +86 800 870 0531/+86 400 624 0406
 香港 +852 3018 6768
 臺灣 +886 277 031 751
 紐約 +1 347 549 4095

電話會議登入名： 6598664

密碼： HUAHONG

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重復收聽會議。

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（“本公司”）是全球領先的純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯及射頻等差異化特色工藝平臺，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是國家“909”工程的載體，是以集成電路製造為主業、面向全球市場、具有自主創新能力和市場競爭力的高科技產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 200mm 晶圓廠（華虹一廠、二廠、及三廠），月產能約 17 萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內新建一條月產能 4 萬片的 300mm 集成電路生產線（華虹七廠）。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零一八年 第二季度 (未經審核)	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一八年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	229,868	198,068	210,093	16.1 %	9.4 %
銷售成本	(152,622)	(132,401)	(142,708)	15.3 %	6.9 %
毛利	77,246	65,667	67,385	17.6 %	14.6 %
毛利率	33.6 %	33.2 %	32.1 %	0.4	1.5
經營開支	(34,030)	(27,371)	(25,447)	24.3 %	33.7 %
其他收入/(損失)淨額	16,082	2,174	(2,025)	639.7 %	(894.2)%
稅前溢利	59,298	40,470	39,913	46.5 %	48.6 %
所得稅(開支)/收益	(13,401)	(6,117)	318	119.1 %	(4,314.2)%
期內溢利	45,897	34,353	40,231	33.6 %	14.1 %
淨利潤率	20.0 %	17.3 %	19.1 %	2.7	0.9
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	45,791	34,353	40,097	33.3 %	14.2 %
非控股權益	106	-	134	-	(20.9)%
每股盈利					
基本	0.04	0.03	0.04	33.3 %	-
攤薄	0.04	0.03	0.04	33.3 %	-
付運晶圓(仟片)	501	459	454	9.2 %	10.4 %
產能利用率 ¹	101.5 %	99.4 %	97.3 %	2.1	4.2
淨資產收益率 ²	10.4 %	8.8 %	9.2 %	1.6	1.2

二零一八年第二季度

- 銷售收入再創新高，達 2.299 億美元，同比增長 16.1%，環比增長 9.4%。
- 銷售成本 1.526 億美元，同比上升 15.3%，主要由於晶圓銷售量上升及折舊成本增加；環比上升 6.9%，主要由於晶圓銷售量上升。
- 毛利率 33.6%，同比上升 0.4 個百分點，主要得益於平均銷售價格提升，部分被折舊成本上升所抵消；環比上升 1.5 個百分點，主要得益於產能利用率的提升。
- 經營開支 3,400 萬美元，同比上升 24.3%，環比上升 33.7%，主要由於計提設備減值準備，及專業服務費用和人工費用的上升。
- 其他收入淨額 1,610 萬美元，同比上升 639.7%，與上季度其他損失淨額 200 萬美元相比，主要得益於(i)本季度取得匯兌收益，而前期均為匯兌損失，(ii)分佔一家聯營公司溢利增加，(iii)獲得的政府補助增加，及(iv)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益。
- 所得稅開支 1,340 萬美元，同比上升 119.1%，主要由於應課稅利潤增加；與上季度所得稅收益 30 萬美元相比，主要由於上季度轉回上年計提的股利代扣代繳稅金。
- 期內溢利 4,590 萬美元，同比上升 33.6%，環比上升 14.1%。
- 淨利潤率 20.0%，同比上升 2.7 個百分點，環比上升 0.9 個百分點。
- 每股盈利 0.04 美元，同比上升 0.01 美元，環比持平。
- 淨資產收益率（年化）10.4%，同比上升 1.6 個百分點，環比上升 1.2 個百分點。

¹ 產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

² 母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一八年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第二季度 % (未經審核)	二零一七年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	225,196	98.0 %	194,502	98.2 %	30,694	15.8 %
其他	4,672	2.0 %	3,566	1.8 %	1,106	31.0 %
銷售收入總額	229,868	100.0 %	198,068	100.0 %	31,800	16.1 %

- 本季度 98.0% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一八年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第二季度 % (未經審核)	二零一七年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	134,502	58.6 %	111,180	56.2 %	23,322	21.0 %
美國	39,805	17.3 %	31,351	15.8 %	8,454	27.0 %
亞洲 ⁴	29,032	12.6 %	21,218	10.7 %	7,814	36.8 %
歐洲	16,542	7.2 %	19,376	9.8 %	(2,834)	(14.6)%
日本 ⁵	9,987	4.3 %	14,943	7.5 %	(4,956)	(33.2)%
銷售收入總額	229,868	100.0 %	198,068	100.0 %	31,800	16.1 %

- 本季度來自中國的銷售收入 1.345 億美元，占銷售收入總額的 58.6%，同比增長 21.0%，主要得益於通用 MOSFET、智能卡芯片、IGBT、超級結和其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度來自美國的銷售收入 3,980 萬美元，同比增長 27.0%，主要得益於超級結、通用 MOSFET、MCU、邏輯和閃存產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 2,900 萬美元，同比增長 36.8%，主要得益於 MCU、超級結和邏輯產品的需求增加。
- 本季度來自歐洲的銷售收入 1,650 萬美元，同比減少 14.6%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度來自日本的銷售收入 1,000 萬美元，同比減少 33.2%，主要由於 MCU 和邏輯產品的需求減少。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一八年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第二季度 % (未經審核)	二零一七年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	88,608	38.6 %	81,033	41.0 %	7,575	9.3 %
分立器件	75,988	33.1 %	52,391	26.5 %	23,597	45.0 %
模擬與電源管理	37,504	16.3 %	35,935	18.1 %	1,569	4.4 %
邏輯及射頻	21,646	9.4 %	22,187	11.2 %	(541)	(2.4)%
獨立非易失性存儲器	6,027	2.6 %	6,041	3.0 %	(14)	(0.2)%
其他	95	-	481	0.2 %	(386)	(80.2)%
銷售收入總額	229,868	100.0 %	198,068	100.0 %	31,800	16.1 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 8,860 萬美元，同比增長 9.3%，主要得益于 MCU 和智能卡芯片的需求增加。
- 本季度分立器件銷售收入 7,600 萬美元，同比增長 45.0%，主要得益于通用 MOSFET、超級結和 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,750 萬美元，同比增長 4.4%，主要得益于其他電源管理和模擬產品的需求增加，部分被 LED 照明產品的需求減少所抵消。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 2,160 萬美元，同比減少 2.4%，主要由於射頻產品的需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點 劃分的銷售收入	二零一八年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第二季度 % (未經審核)	二零一七年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
0.13μm 及以下	83,383	36.3 %	63,734	32.2 %	19,649	30.8 %
0.15μm 及 0.18μm	31,108	13.5 %	34,502	17.4 %	(3,394)	(9.8)%
0.25μm	3,697	1.6 %	5,194	2.6 %	(1,497)	(28.8)%
0.35μm 及以上	111,680	48.6 %	94,638	47.8 %	17,042	18.0 %
銷售收入總額	229,868	100.0 %	198,068	100.0 %	31,800	16.1 %

- 本季度 0.13μm 及以下工藝技術節點的銷售收入 8,340 萬美元，同比增長 30.8%，主要得益于智能卡芯片、MCU 和邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點的銷售收入 3,110 萬美元，同比減少 9.8%，主要由於智能卡芯片和模擬產品的需求減少。
- 本季度 0.25μm 工藝技術節點的銷售收入 370 萬美元，同比減少 28.8%，主要由於邏輯產品和智能卡芯片的需求減少。
- 本季度 0.35μm 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.117 億美元，同比增長 18.0%，主要得益于通用 MOSFET 和超級結產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一八年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第二季度 % (未經審核)	二零一七年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	145,707	63.4 %	133,870	67.6 %	11,837	8.8 %
工業及汽車	47,323	20.6 %	26,145	13.2 %	21,178	81.0 %
通訊	25,741	11.2 %	28,994	14.6 %	(3,253)	(11.2)%
計算機	11,097	4.8 %	9,059	4.6 %	2,038	22.5 %
銷售收入總額	229,868	100.0 %	198,068	100.0 %	31,800	16.1 %

- 本季度電子消費品仍然是我們第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.457 億美元，占銷售收入總額的 63.4%，同比增長 8.8%，主要得益于通用 MOSFET 和超級結產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 4,730 萬美元，同比增長 81.0%，主要得益于智能卡芯片、MCU、IGBT 和超級結產品的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 2,570 萬美元，同比減少 11.2%，主要由於智能卡芯片和邏輯產品的需求減少。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,110 萬美元，同比增長 22.5%，主要得益于通用 MOSFET 和 MCU 產品的需求增加。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一八年 第二季度 (未經審核)	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一八年 第一季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	65	60	63
2 號晶圓廠	59	57	57
3 號晶圓廠	48	42	48
合計	172	159	168
產能利用率	101.5%	99.4%	97.3%

- 得益于客戶需求的增加，本季度產能利用率達 101.5%，同比上升 2.1 個百分點，環比上升 4.2 個百分點。本季度末總產能達每月 172,000 片。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一八年 第二季度 (未經審核)	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一八年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	501	459	454	9.2 %	10.4 %

- 本季度付運晶圓 501,000 片，同比增加 9.2%，主要由於客戶需求的增加。

經營開支分析

以千美元計	二零一八年 第二季度 (未經審核)	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一八年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	1,963	1,753	1,749	12.0 %	12.2 %
管理費用 ⁷	32,067	25,618	23,698	25.2 %	35.3 %
經營開支	34,030	27,371	25,447	24.3 %	33.7 %

- 經營開支 3,400 萬美元，同比上升 24.3%，環比上升 33.7%，主要由於計提設備減值準備，及專業服務費用和人工費用的上升。

其他收入/(損失)淨額

以千美元計	二零一八年 第二季度 (未經審核)	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一八年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,433	3,299	3,419	4.1 %	0.4 %
利息收入	2,057	1,533	2,720	34.2 %	(24.4)%
以公允價值計量且變動計入當期損益 的金融資產之公允價值變動收益	1,787	-	-	-	-
匯兌收益/(損失)	1,731	(2,689)	(8,823)	(164.4)%	(119.6)%
分佔一家聯營公司溢利	4,708	157	453	2,898.7 %	939.3 %
財務費用	(690)	(534)	(594)	29.2 %	16.2 %
政府補貼	2,726	210	420	1,198.1 %	549.0 %
其他	330	198	380	66.7 %	(13.2)%
其他收入/(損失)淨額	16,082	2,174	(2,025)	639.7 %	(894.2)%

- 其他收入淨額 1,610 萬美元，同比上升 639.7%，與上季度其他損失淨額 200 萬美元相比，主要得益於(i)本季度取得匯兌收益，而前期均為匯兌損失，(ii)分佔一家聯營公司溢利增加，(iii)獲得的政府補助增加，及(iv)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益。

⁷管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零一八年 第二季度 (未經審核)	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一八年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	51,953	64,575	57,542	(19.5)%	(9.7) %
投資活動所用現金流量淨額	(155,088)	(114,525)	(12,281)	35.4 %	1,162.8 %
融資活動所得/(用)現金流量淨額	333,523	(40,236)	189,645	(928.9)%	75.9 %
外匯匯率變動影響淨額	(11,327)	3,835	7,865	(395.4)%	(244.0) %
現金及現金等價物變動影響淨額	219,061	(86,351)	242,771	(353.7)%	(9.8)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 5,200 萬美元，同比下降 19.5%，主要由於上年同期從一家關聯公司收到房租款。
- 投資活動所用現金流量淨額 1.551 億美元，其中包括(i)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產投資支出 1.978 億美元，(ii)設備投資支出 2,890 萬美元，部分被(a)收回定期存款投資 6,780 萬美元，及(b)收到利息收入 380 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 3.335 億美元，其中包括(i)控股子公司華虹半導體（無錫）有限公司收到資本金 3.770 億美元，(ii)因股票期權行權而增發股份收到的投資款 60 萬美元，部分被(i)支付股息 4,110 萬美元，(ii)償還銀行貸款本金 230 萬美元，及(iii)支付利息 70 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於六月三十日 二零一八年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一八年 (未經審核)
資產總額	2,670,444	2,375,277
負債總額	389,174	381,954
所有者權益總額	2,281,270	1,993,323
資產負債率 ⁸	14.6%	16.1%

資本開支

以千美元計	二零一八年 第二季度 (未經審核)	二零一八年 第一季度 (未經審核)
華虹宏力	25,768	36,894
華虹無錫	3,117	49,797
合計	28,885	86,691

- 本季度資本開支 2,890 萬美元，其中 310 萬美元用於華虹無錫。

⁸資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於六月三十日 二零一八年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一八年 (未經審核)
存貨	127,997	128,255
貿易應收款項及應收票據	121,528	125,639
預付款項、按金及其他應收款項	11,346	11,163
應收關聯方款項	51,496	52,052
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	190,134	-
已凍結存款及定期存款	64,069	125,236
現金及現金等價物	836,722	617,661
流動資產總額	1,403,292	1,060,006
貿易應付款項	66,561	69,037
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	143,445	110,505
計息銀行借款	60,694	60,931
政府補助	42,205	44,410
應付關聯方款項	19,055	22,143
應付所得稅	18,888	33,660
流動負債總額	350,848	340,686
淨營運資金	1,052,444	719,320
速動比率	3.6x	2.7x
流動比率	4.0x	3.1x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	54	57
存貨周轉天數	76	77

- 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產本季度末為 1.901 億美元，系從銀行購買的理財產品。
- 已凍結存款及定期存款由上季度末的 1.252 億美元下降至本季度末的 6,410 萬美元，主要由於收回定期存款投資。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 1.105 億美元上升至本季度末的 1.434 億美元，主要由於(i)資本支出應付款增加，(ii)應付股利增加，及(iii)計提半年度獎金。
- 應付關聯方款項由上季度末的 2,210 萬美元下降至本季度末的 1,910 萬美元，主要由於確認了本季度的關聯方房屋租金。
- 應付所得稅由上季度末的 3,370 萬美元下降至本季度末的 1,890 萬美元，主要由於支付 2017 年度所得稅，部分被計提本季度所得稅開支所抵消。
- 本季度末淨營運資金 10.524 億美元，流動比率 4.0。
- 本季度貿易應收款項及應收票據周轉天數 54 天。
- 本季度存貨周轉天數為 76 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零一八年 (未經審核)	於六月三十日 二零一七年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一八年 (未經審核)
銷售收入	229,868	198,068	210,093
銷售成本	(152,622)	(132,401)	(142,708)
毛利	77,246	65,667	67,385
其他收入及收益	12,530	5,240	6,647
銷售及分銷費用	(1,963)	(1,753)	(1,749)
管理費用	(32,067)	(25,618)	(23,698)
其他費用	(466)	(2,689)	(8,531)
財務費用	(690)	(534)	(594)
分佔一家聯營公司溢利	4,708	157	453
稅前溢利	59,298	40,470	39,913
所得稅(開支)/收益	(13,401)	(6,117)	318
期內溢利	45,897	34,353	40,231
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	45,791	34,353	40,097
非控股權益	106	-	134
持有人應佔每股盈利			
基本	0.04	0.03	0.04
攤薄	0.04	0.03	0.04
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,039,907,108	1,033,871,656	1,039,145,939
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,052,787,108	1,043,950,656	1,051,206,939

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於六月三十日 二零一八年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於六月三十日 二零一七年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	727,636	752,938	714,933
投資物業	177,349	186,614	173,132
預付土地租賃款項	61,521	21,267	20,228
無形資產	6,693	7,380	8,282
於聯營公司的投資	61,928	60,285	46,059
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	216,177	224,313	208,210
長期預付款項	8,016	55,005	5,434
遞延稅項資產	7,832	7,469	7,097
非流動資產總額	1,267,152	1,315,271	1,183,375
流動資產			
存貨	127,997	128,255	100,875
貿易應收款項及應收票據	121,528	125,639	107,565
預付款項、按金及其他應收款項	11,346	11,163	11,836
應收關聯方款項	51,496	52,052	53,013
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	190,134	-	-
已凍結存款及定期存款	64,069	125,236	202,834
現金及現金等價物	836,722	617,661	241,437
流動資產總額	1,403,292	1,060,006	717,560
流動負債			
貿易應付款項	66,561	69,037	60,999
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	143,445	110,505	116,474
計息銀行借款	60,694	60,931	4,133
政府補助	42,205	44,410	38,880
應付關聯方款項	19,055	22,143	16,223
應付所得稅	18,888	33,660	16,259
流動負債總額	350,848	340,686	252,968
流動資產淨額	1,052,444	719,320	464,592
總資產減流動負債	2,319,596	2,034,591	1,647,967
非流動負債			
計息銀行借款	29,471	33,396	89,373
遞延稅項負債	8,855	7,872	3,331
非流動負債總額	38,326	41,268	92,704
淨資產	2,281,270	1,993,323	1,555,263
權益和負債權益			
股本	1,558,999	1,557,264	1,550,164
儲備	165,406	246,891	5,099
本公司擁有人應佔權益	1,724,405	1,804,155	1,555,263
非控股權益	556,865	189,168	-
權益總額	2,281,270	1,993,323	1,555,263

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零一八年 (未經審核)	於六月三十日 二零一七年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一八年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利	59,298	40,470	39,913
折舊及攤銷	29,436	25,153	30,178
應佔聯營公司溢利	(4,708)	(157)	(453)
營運資金的變動及其它	(32,073)	(891)	(12,096)
經營活動所得現金流量淨額	51,953	64,575	57,542
投資活動所用現金流量：			
購買物業、廠房及設備項目	(28,885)	(43,329)	(86,691)
其他投資活動所(用)/得現金流量	(126,203)	(71,196)	74,410
投資活動所用現金流量	(155,088)	(114,525)	(12,281)
融資活動所得/(用)現金流量：			
非控股權益資本注資	377,000	-	188,000
發行股份所得收益	620	-	2,186
向股東支付股息	(27,221)	(39,673)	-
已凍結存款的增加	(13,867)	(25)	-
償還銀行貸款	(2,267)	-	-
已付利息	(742)	(538)	(541)
融資活動所得/(用)現金流量	333,523	(40,236)	189,645
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	230,388	(90,186)	234,906
外匯匯率變動影響淨額	(11,327)	3,835	7,865
期初現金及現金等價物	617,661	327,788	374,890
期末現金及現金等價物	836,722	241,437	617,661

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波

馬玉川

森田隆之

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零一八年八月七日